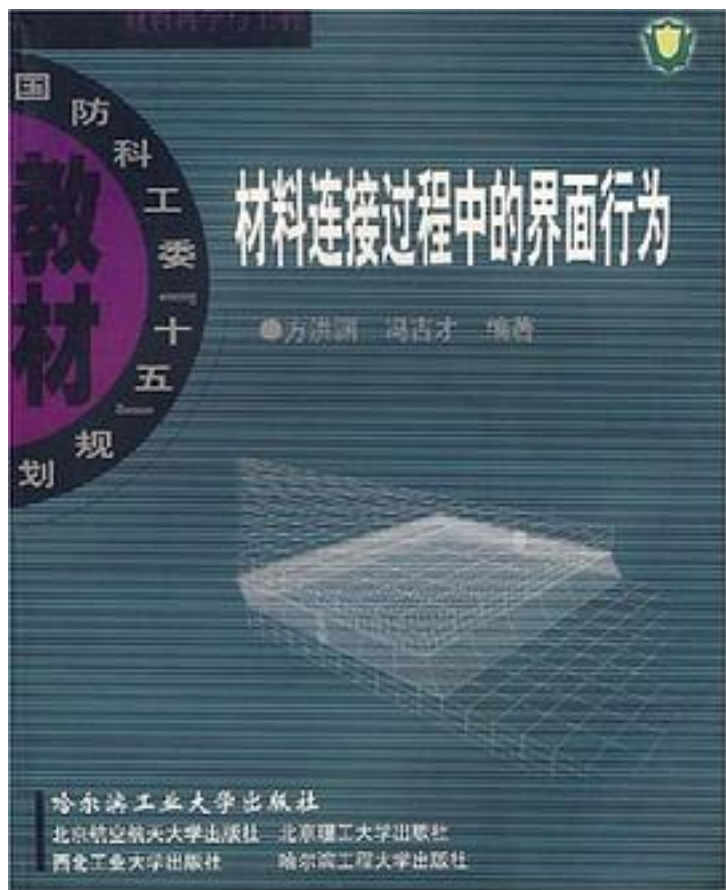


# 材料连接过程中的界面行为



[材料连接过程中的界面行为\\_下载链接1](#)

著者:方洪渊

出版者:哈尔滨工业大学出版社发行部

出版时间:2005-9

装帧:简装本

isbn:9787560321936

本书是国防科工委“十五”规划重点教材。本书以材料连接过程中的界面行为为切入点来阐述连接接头形成的物理本质。本书主要结合钎焊和扩散连接过程，重点论述材料过程中的固相与固相和固相与液相之间的相互作用问题，分析讨论接头形成过程所涉及到的溶解、扩散、氧化膜去除、界面反应及反应路径等与界面行为相关的问题。

本书可作为材料加工工程学科的硕士研究生的主要专业课教材，还可作为焊接技术与工程专业本科生和材料成形及控制工程专业研修焊接方向的本科生的教学参考书，也可供从事材料连接工作的研究人员和工程技术人员参考。

作者介绍:

目录:

[材料连接过程中的界面行为\\_下载链接1\\_](#)

标签

专业

界面

评论

很容易读完的专业书

-----  
[材料连接过程中的界面行为\\_下载链接1\\_](#)

书评

-----  
[材料连接过程中的界面行为\\_下载链接1\\_](#)